



企業理念・100億宣言に向けた経営者メッセージ



代表取締役
高田 義久

マイクロメートル以内の加工技術を世界の先端半導体装置へ

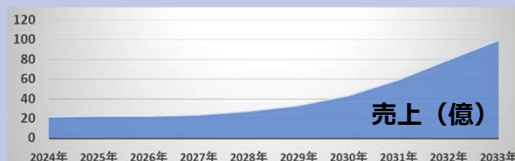
当社は半導体装置の世界トップシェアを誇る**半導体製造装置メーカー※1のT1企業**として、半導体製造装置用中核部材の供給を担い、最先端の半導体関連製造装置の開発と量産をリードしている。

半導体装置のグローバル市場が拡大するなか、当社の製造技術を活かせる先端領域をターゲットに高付加価値型商品のさらなる供給をはかる。**先端半導体装置用高度中核部材というニッチかつ非常に重要な分野**を選択し、今後高まり続けるニーズを捉える。

売上高100億円実現の目標と課題

実現目標

2030年の売上高達成に向け、当社の生産体制を拡充し、付加価値の高い先端半導体製造装置用中核部材を市場に供給する。



課題

- ・取引先メーカー※1からは、半導体製造装置用中核部材のさらなる増産依頼が来ており、当社にとって大きな商機が訪れている。しかし、**既存の生産体制では限界であり、新たな大型受注に対応できる状態にない。**
- ・生産体制の確立をはかるため、大規模な投資を行い、**生産力を拡充することが急務**になっている。

売上高100億円実現に向けた具体的措置

目指す成長手段

- ・大規模な設備投資によって、当社の製造体制を拡充し、**次世代型半導体製造装置※2の部品提供体制を構築する。**
- ・これらの部品は国内製造が必須であるが、加工難度が高く当社以外に国内で十分な対応ができる事業者がいない。そのため、対象分野では当社の技術力を発揮し、市場内での大きなシェアが獲得できる。
- ・半導体関連製造装置の部品製造を支える立場として、従業員ならびに協力会社の繁栄、雇用を通じた地域貢献を目指す。

実施体制

- ・半導体回路・ウエハーを研磨する装置部品、半導体エッチング装置などの次世代型半導体製造装置※2の部品製造にあたっては、機密事項も多く、高い要求水準が求められることから、協力企業ならびに取引先メーカー※1の技術担当者との密な連携と情報共有により、製品開発および量産シフトを進める。

※1：機密事項のためメーカー名非公表

※2：機密事項のため装置名非公表

※本宣言は企業自身がその責任において売上高100億円を目指して、自社の取組を進める旨を宣言するものです

当社が製造する半導体装置用中核部材

○本社所在地：静岡県沼津市本白銀町639

○事業概要：国内でも有数のマイクロメートル以内の要求精度に対応できる金属加工業者として、半導体製造装置用中核部材等を製造販売している。

○常時使用する従業員：82人（2024年12月期）

○現在の売上高：22億円（2024年12月期）

○法人番号：1080101001054

○Web：

<https://www.takadatekkojyo.com/>

売上高100億円実現に向けた具体的措置

経営理念：厳格な品質管理とたゆまぬ技術革新に努め、顧客の繁栄に貢献する

当社は半導体装置の世界トップシェアを誇る**半導体装置メーカー※1のT1企業**として、半導体製造装置用中核部材の供給を担い、最先端の半導体関連製造装置の開発と量産をリードしている希少な金属加工業者である。

当社の金属加工技術は、業界でも高い評価を受けており、あらゆる半導体製造メーカーに採用され活用されている。半導体製造業界の特性として、半導体関連製品は、コピーイクザクトリー・コピーコントロールを行い、高品質な製品を継機的に供給する責任が求められる。



主要製品※2

- ◆ 半導体回路・ウェハーを研磨する装置部品
- ◆ 半導体エッチング装置
- ◆ 真空ポンプ用ローターなどの半導体製造装置の基幹部品
- ◆ 有機ELパネル製造装置部品
- ◆ 液晶パネル製造装置部品
- ◆ カーバッテリー用製造装置部品

当社の製品例（精密部品）



取引先※1からの数々の受賞



取引先メーカー※1が掲げる2030年度に向けた長期ビジョン「**E-Vision2030：技術で、熱く、世界を支える**」と共に成長を遂げ、10年後の当社の企業価値向上の目安として、売上100億円規模を設定する。

中長期経営計画の3つの要素

- ①**技術面**：先端半導体装置※2用部材の開発製造技術を磨く
- ②**経済面**：半導体関連製造装置の部品製造リードする立場として、市場ニーズを取り込み、国産の高品質な部材を市場に安定供給し、収益基盤を拡充する
- ③**地域・環境面**：従業員ならびに協力会社の繁栄、雇用を通じた地域貢献を目指す

